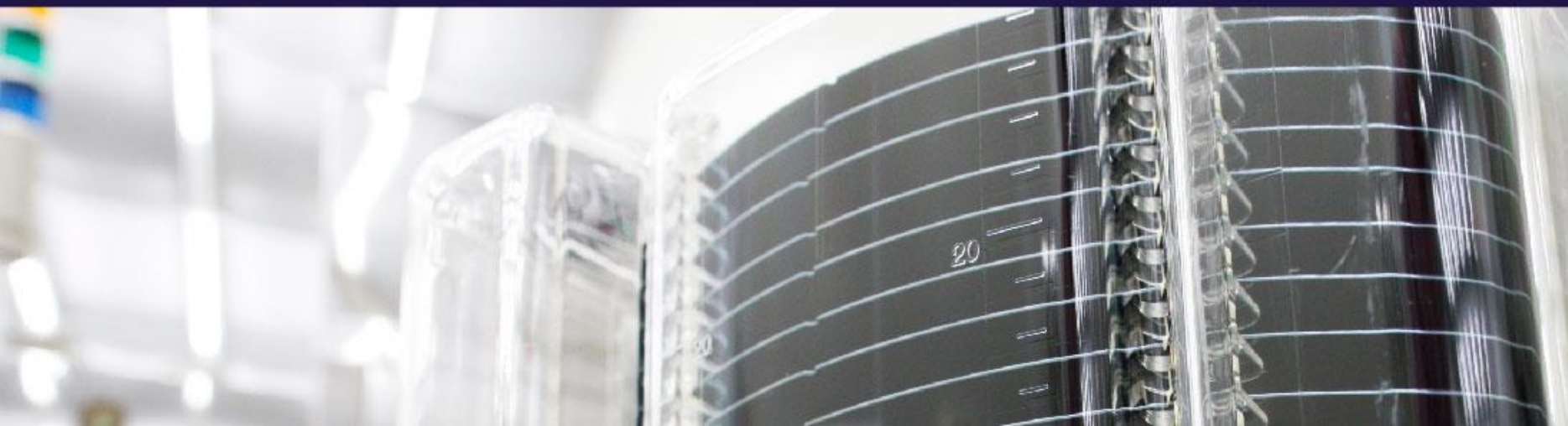


第3四半期連結決算の概要

2016年1月29日

堀 哲朗
取締役常務執行役員



2016年3月期 第3四半期のハイライト

- 5四半期連続で、売上総利益率、営業利益率が高水準を維持
- 第3四半期のSPE受注額が第2四半期比30%増加。
ファウンドリおよび3D-NANDが期待通り伸長
- 1,540万株の自己株式取得が完了、1月20日に全株式を消却

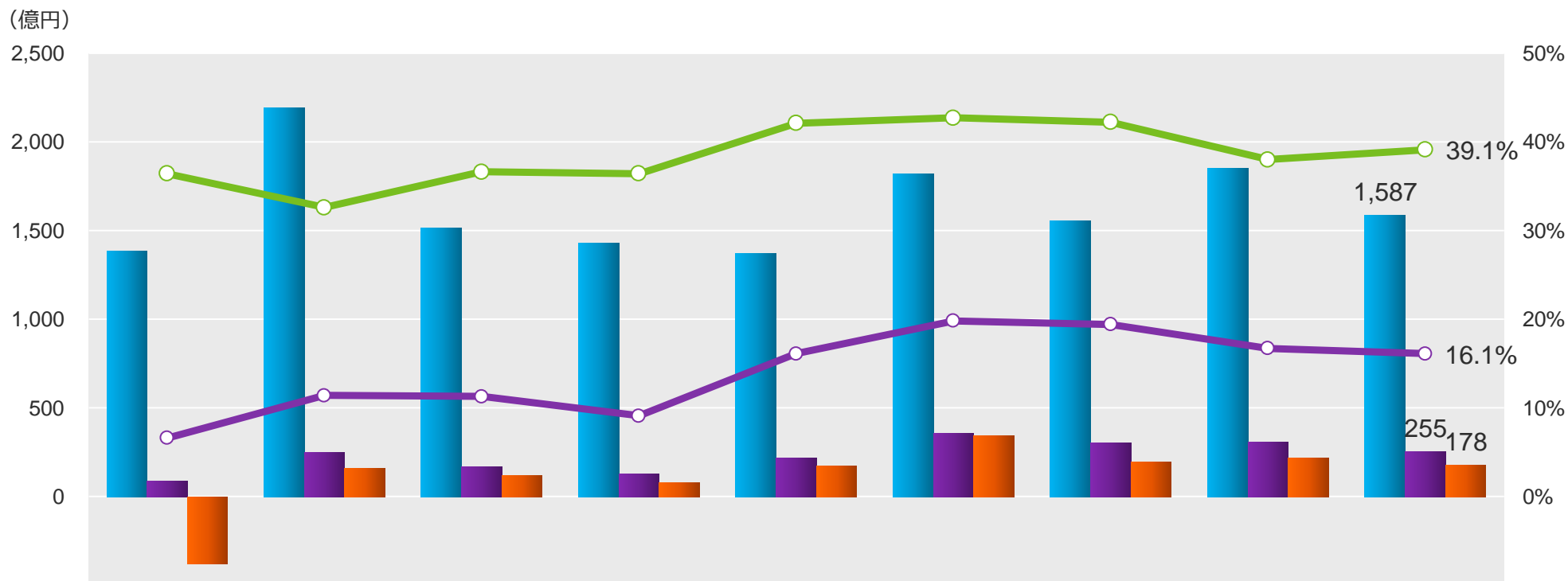
損益状況

(億円)

	2016年3月期			1Q-3Q		
	1Q	2Q	3Q	FY16	FY15	対前年同期 増減
売上高	1,557	1,851	1,587	4,997	4,312	+15.9%
売上総利益 下段：売上総利益率	657 42.2%	703 38.0%	620 39.1%	1,980 39.6%	1,650 38.3%	+20.0% +1.3pts
販管費	354	393	365	1,113	1,128	-1.4%
営業利益 下段：営業利益率	302 19.4%	309 16.7%	255 16.1%	867 17.4%	521 12.1%	+66.2% +5.3pts
税前利益	290	284	251	826	538	+53.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	194	218	178	592	374	+58.1%
研究開発費	175	200	183	559	517	+8.0%
設備投資額	21	26	28	76	99	-22.7%
減価償却実施額	46	47	49	142	151	-6.0%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

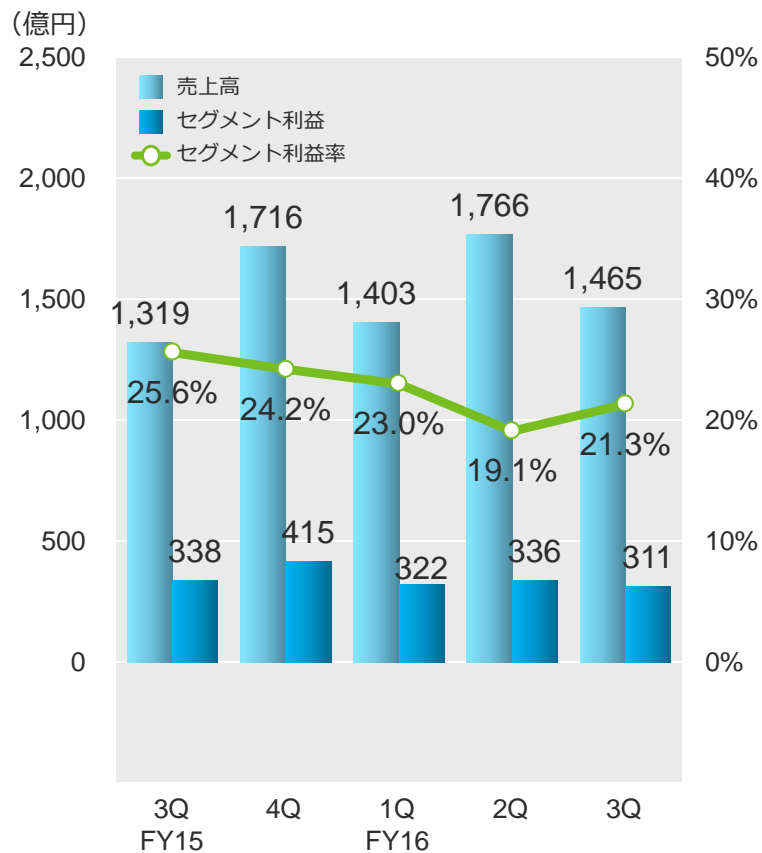
損益状況



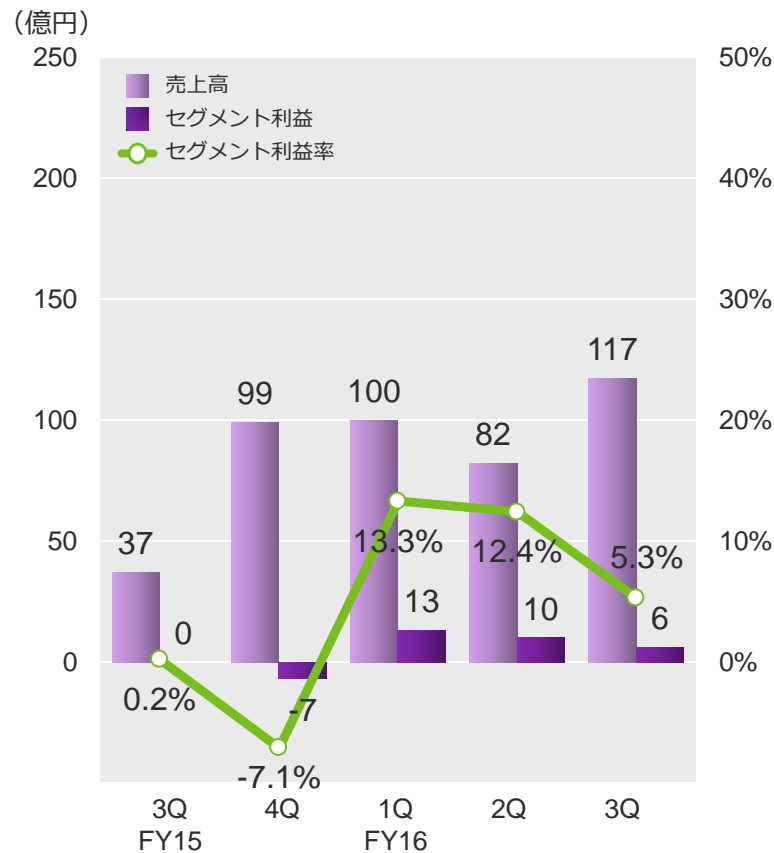
	3Q FY14	4Q	1Q FY15	2Q	3Q	4Q	1Q FY16	2Q	3Q
■ 売上高	1,384	2,192	1,513	1,429	1,370	1,818	1,557	1,851	1,587
■ 営業利益	90	249	170	130	220	359	302	309	255
■ 親会社株主に帰属する 当期純利益	-380	162	118	81	174	344	194	218	178
● 売上総利益率	36.4%	32.6%	36.6%	36.4%	42.1%	42.7%	42.2%	38.0%	39.1%
● 営業利益率	6.6%	11.4%	11.3%	9.1%	16.1%	19.8%	19.4%	16.7%	16.1%

セグメント情報

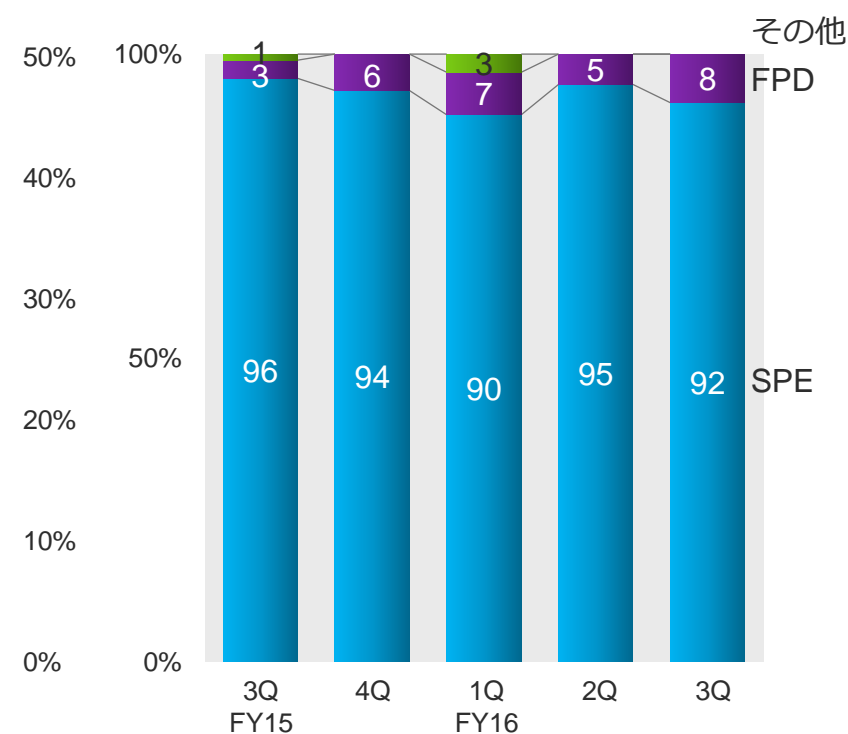
SPE (半導体製造装置)



FPD (FPD製造装置)

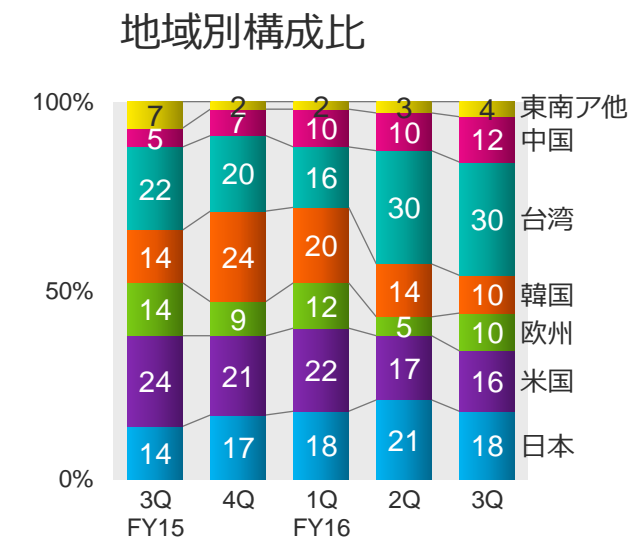
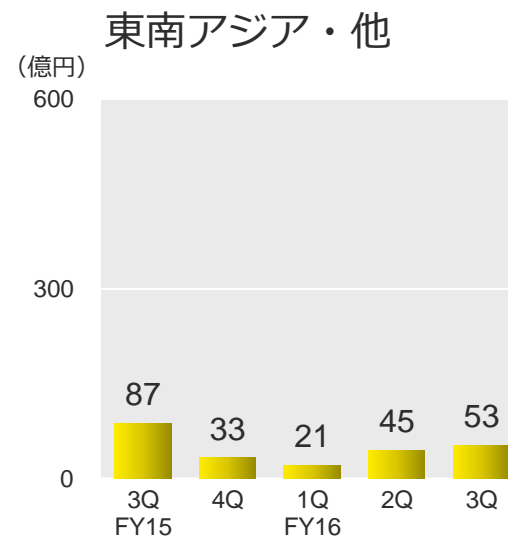
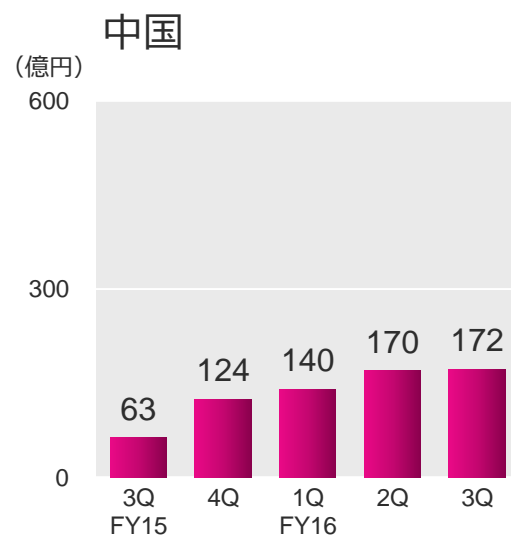
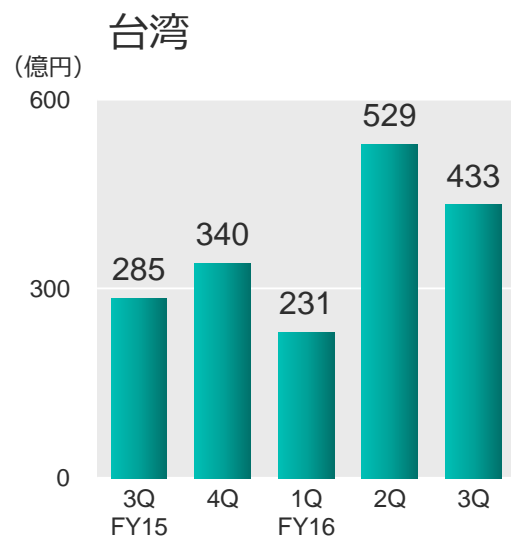
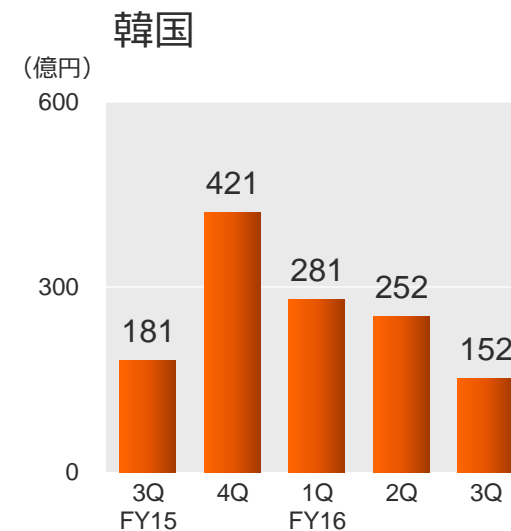
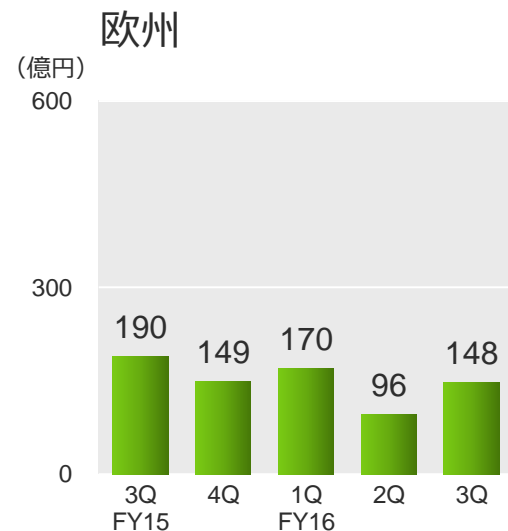
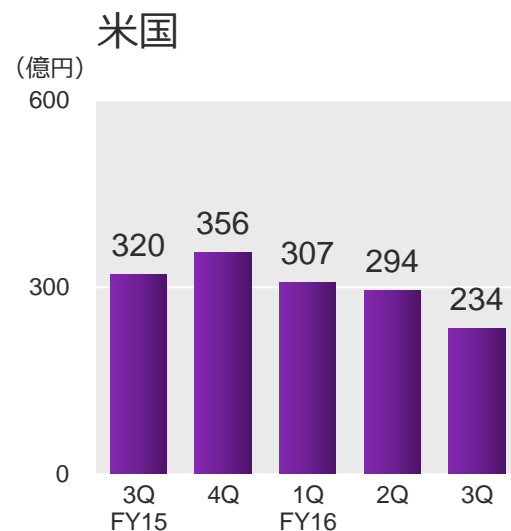
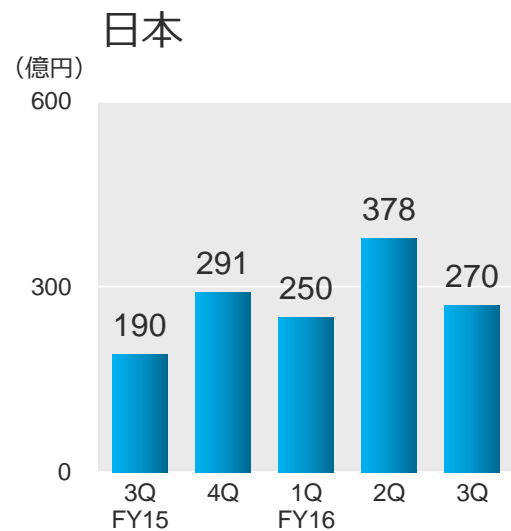


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、FY16/1Qより報告セグメントから除外しました。
4. 売上構成比率において、PV製造装置事業はその他に含めています。

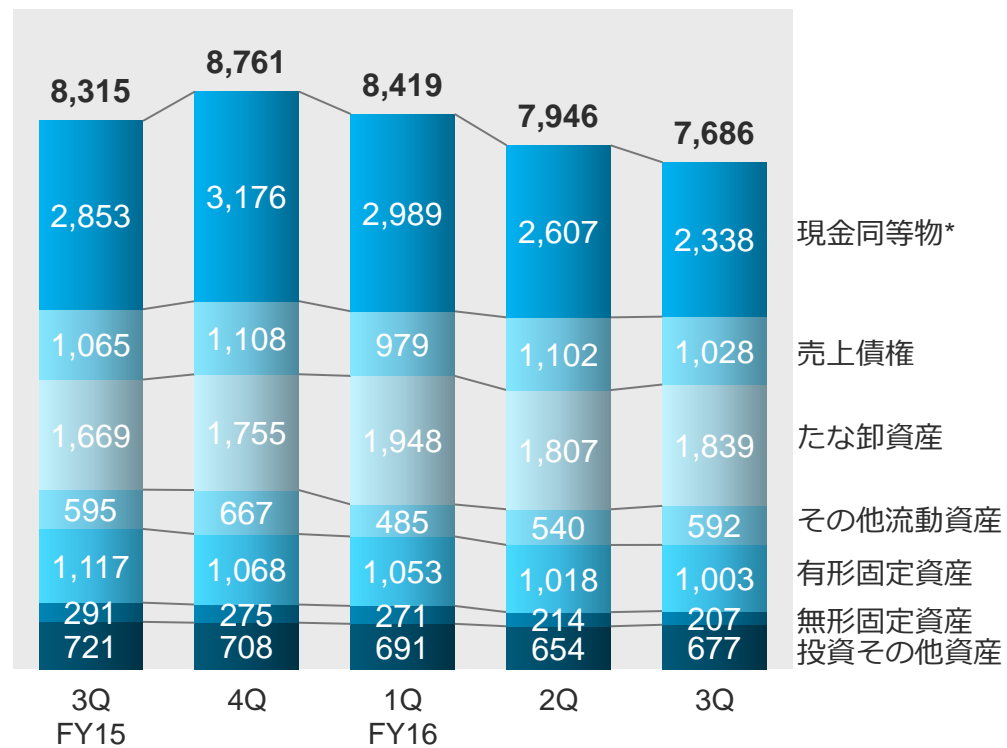
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

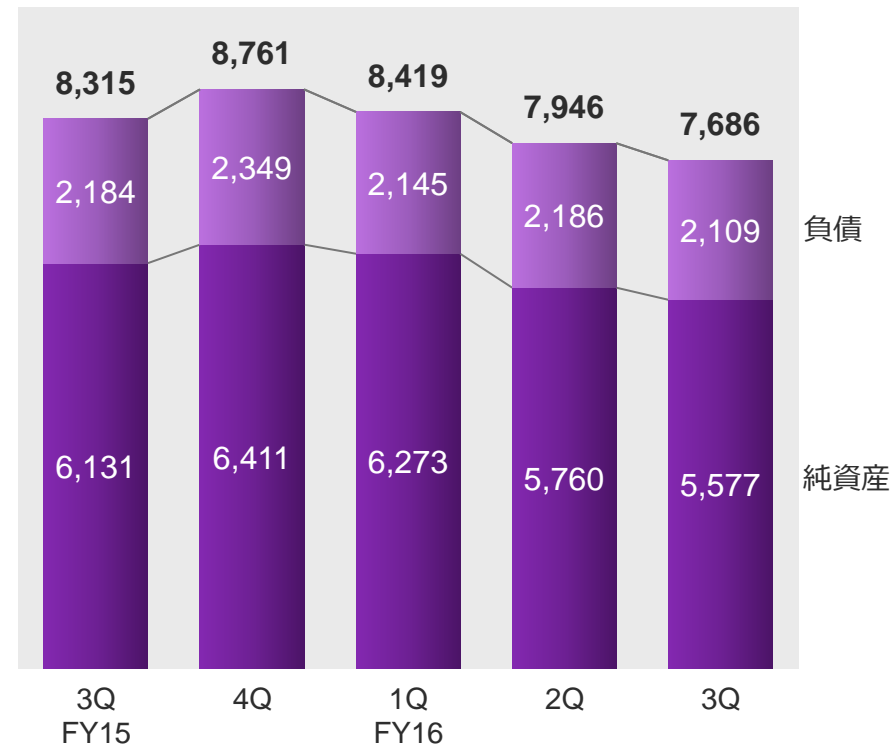
資産

(億円)



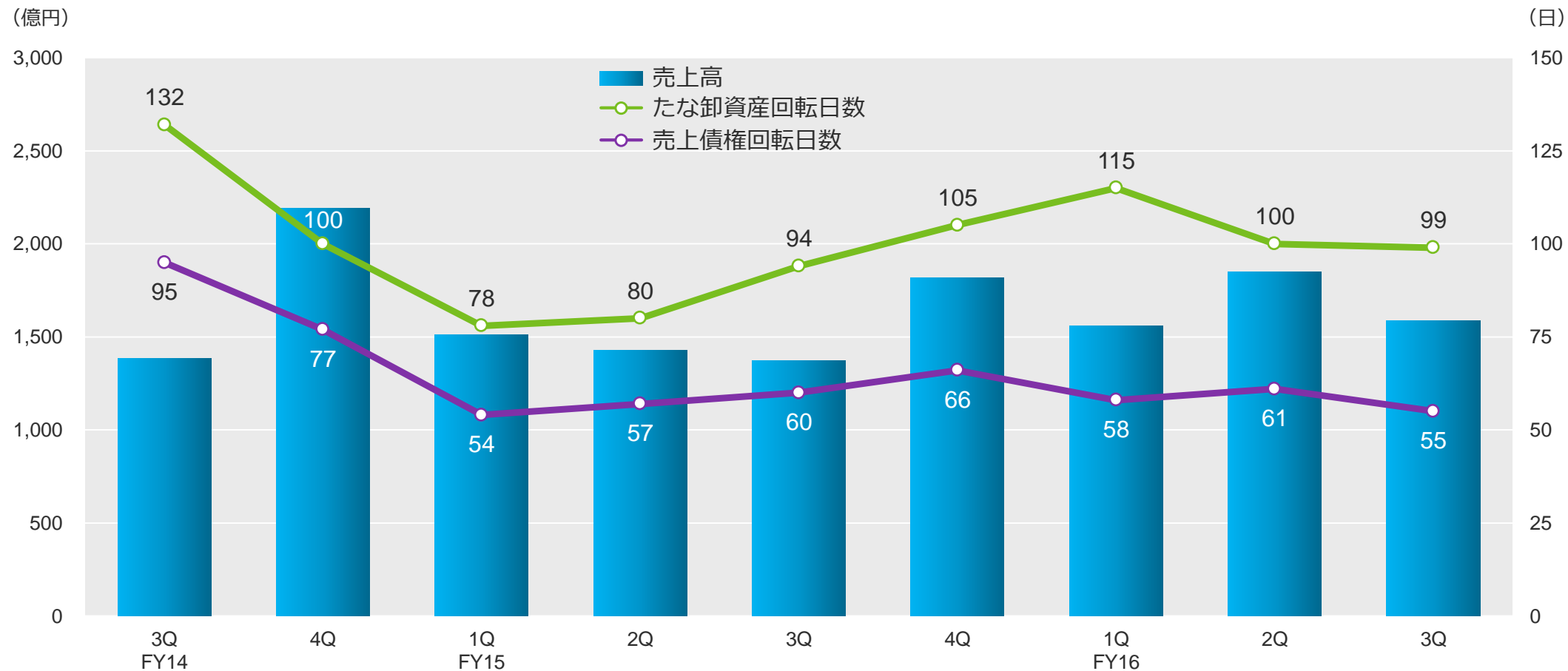
負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金＋短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

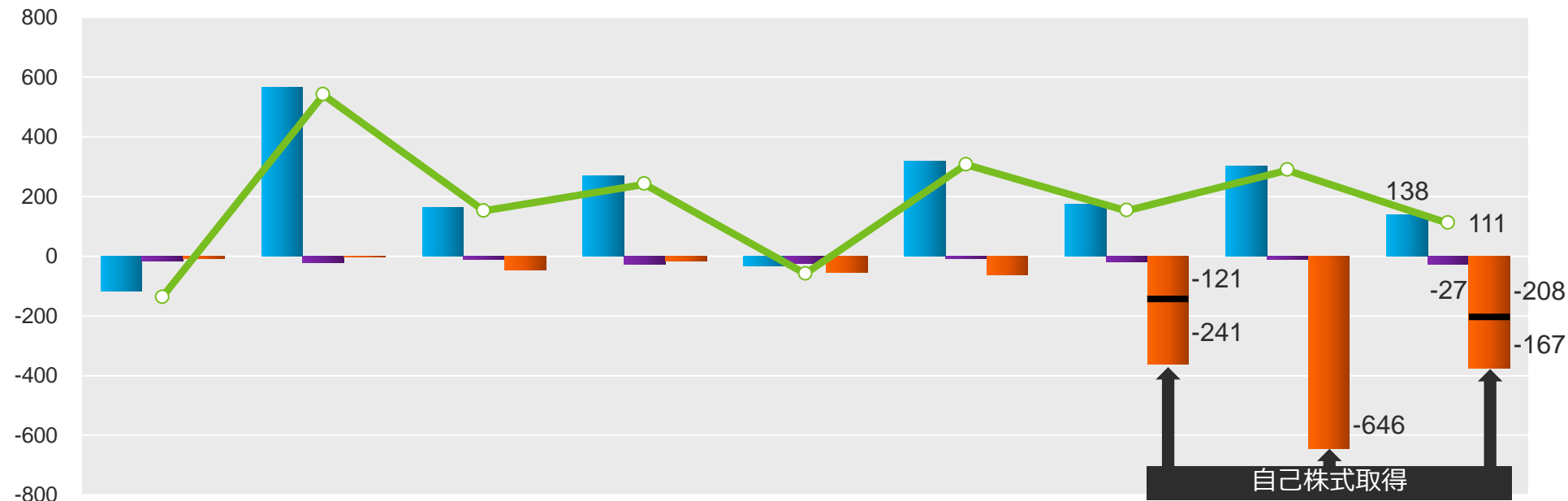
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)



	3Q FY14	4Q FY14	1Q FY15	2Q FY15	3Q FY15	4Q FY15	1Q FY16	2Q FY16	3Q FY16
営業キャッシュ・フロー	-118	565	164	268	-32	317	173	301	138
投資キャッシュ・フロー*	-18	-23	-12	-27	-26	-9	-20	-12	-27
財務キャッシュ・フロー	-8	-4	-46	-18	-54	-62	-363	-646	-375
フリーキャッシュフロー**	-137	541	152	241	-59	307	153	288	111
手元資金残高***	2,125	2,681	2,800	2,991	2,853	3,176	2,989	2,607	2,338

*投資キャッシュフローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

**フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

***手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

自己株式の買い入れ・消却が完了

自己株式：1,540万株の消却完了（2016年1月20日）
（消却前の発行済株式の総数に対する割合8.53%）

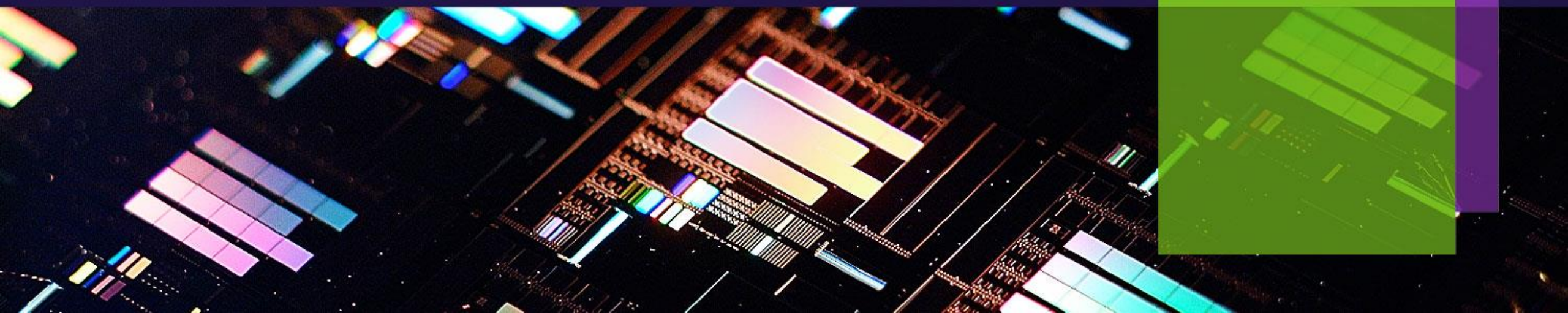
消却後の発行済株式の総数：165,210,911株



事業環境および新生TELの目指す姿

2016年1月29日

河合 利樹
代表取締役社長、CEO



事業環境

▶ 半導体設備投資

CY2016の半導体前工程（WFE）の設備投資額は、前年同水準を見込む。

- メモリ：DRAM向け投資は一巡、3D-NAND向け投資が拡大
- ファウンドリ／ロジック：スマートフォン・PC需要の鈍化はあるが、先端ノード向け投資が立ち上がり、全体としては前年同水準

▶ FPD設備投資

CY2016のFPD用製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資を中心に堅調を予想、前年同水準を見込む。

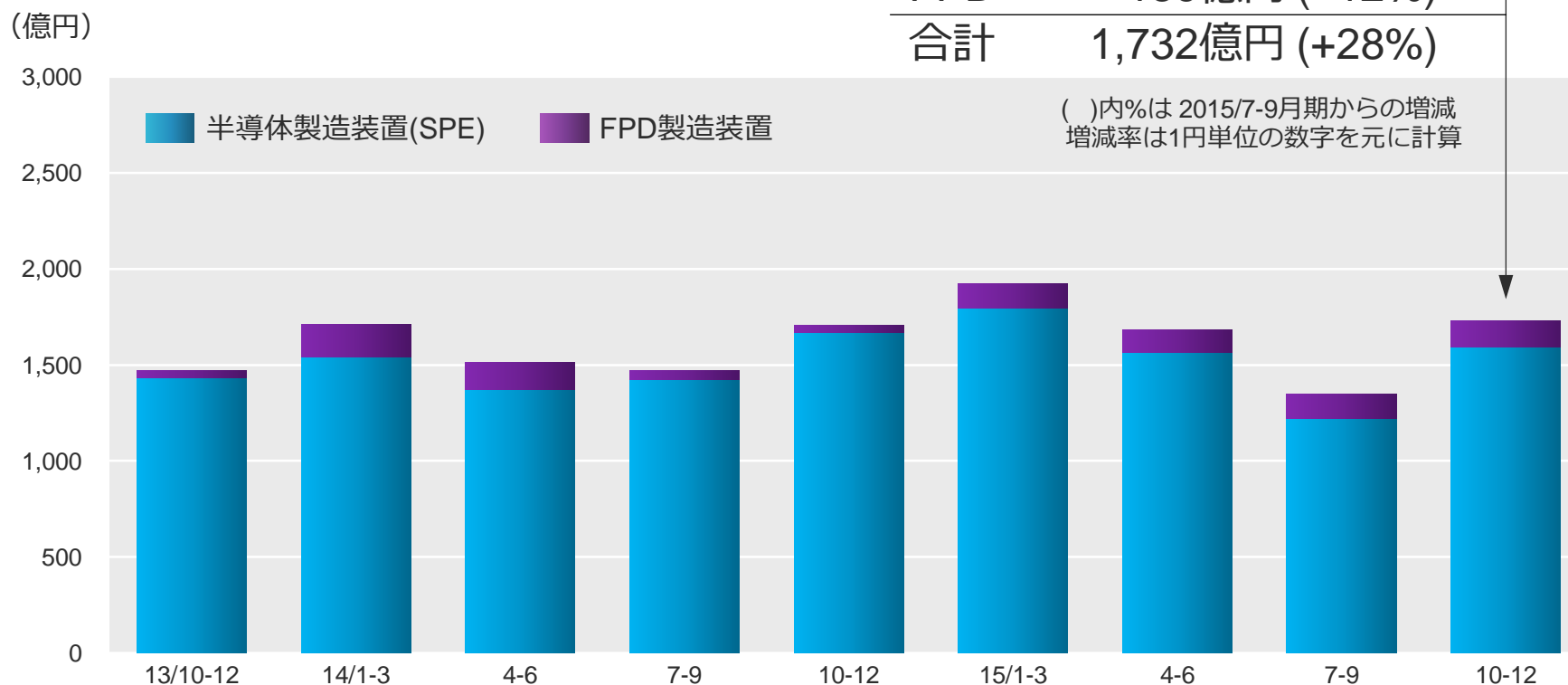
(2016年1月時点での見方)

半導体の製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組み立て・検査をする後工程があります。WFE（Wafer Fab Equipment）は、この前工程で使用される製造装置を示します。

四半期 受注額

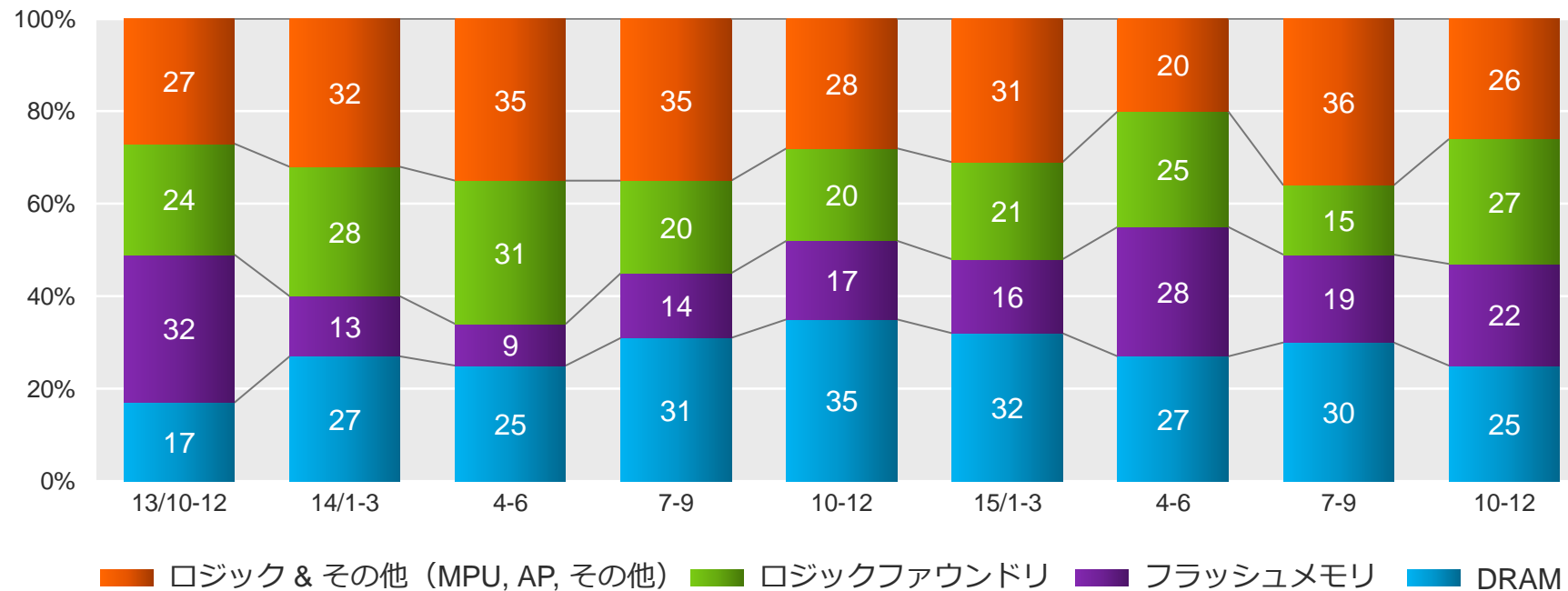
2015/10-12月期

SPE	1,593億円 (+30%)
FPD	139億円 (+12%)
合計	1,732億円 (+28%)



2015/4-6月期より、PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、報告セグメントから除外しました。
これにより、受注額についても非開示としています。

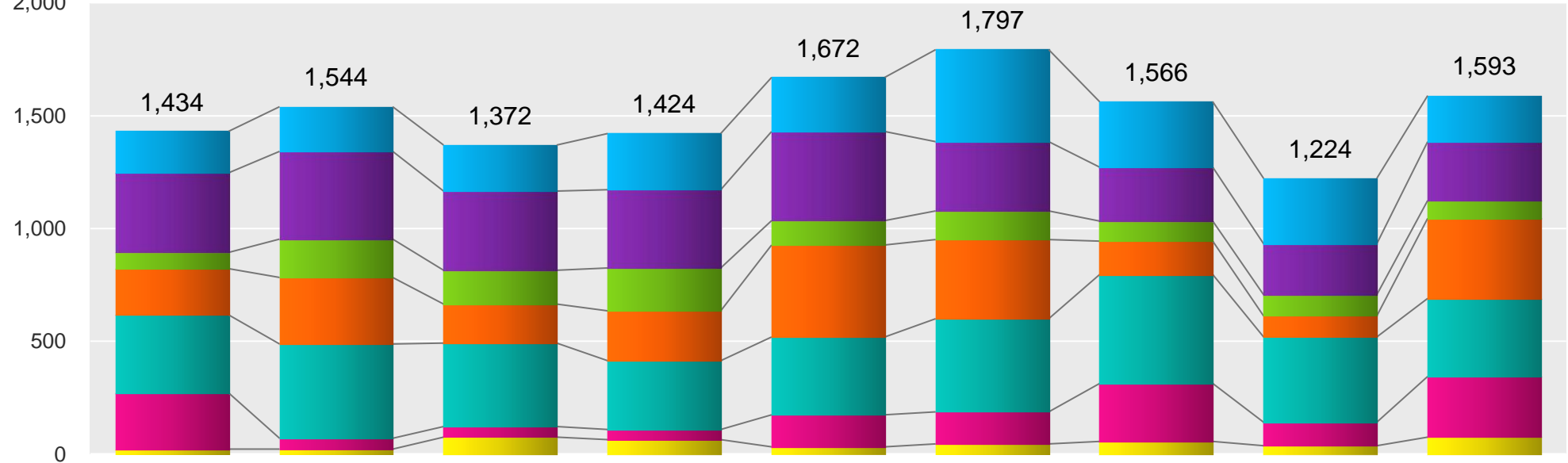
SPE受注アプリケーション別構成比



グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額

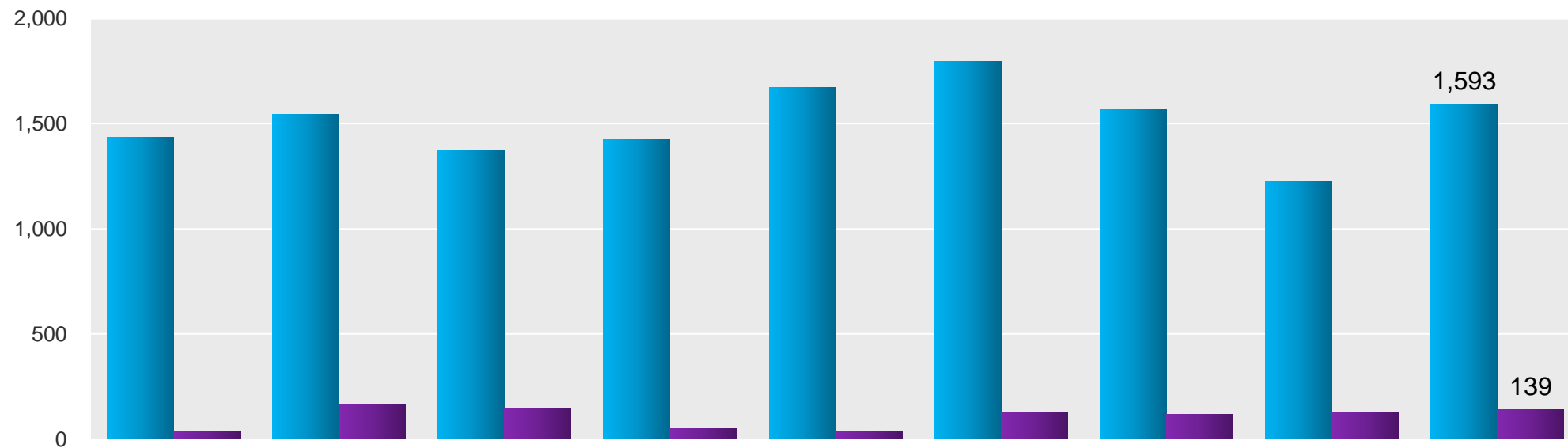
(億円)
2,000



	13/10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12
■ 国内	184	198	204	249	240	408	290	290	204
■ 米国	353	389	351	347	395	307	239	226	261
■ 欧州	72	170	150	190	108	127	89	94	79
■ 韓国	205	295	173	221	408	351	148	93	355
■ 台湾	346	418	370	305	345	413	483	378	346
■ 中国	249	48	47	45	142	142	257	104	269
■ 東南アジア・他	22	22	75	64	32	45	56	37	75

受注額・受注残高

(億円)



	13/10-12	14/1-3	4-6	7-9	10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12
■ SPE受注額	1,434	1,544	1,372	1,424	1,672	1,797	1,566	1,224	1,593
■ FPD受注額	38	166	142	48	34	126	118	125	139
SPE受注残高	2,372	2,099	2,110	2,170	2,523	2,604	2,767	2,226	2,354
FPD受注残高	225	290	293	291	288	316	333	376	399

2015/4-6月期より、PV製造装置事業については、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」に定める重要性を満たさなくなったため、報告セグメントから除外しました。これにより、受注額、受注残高についても非開示としています。

2016年3月期 業績予想（2015年10月27日発表から変更なし）

- 収益性が向上、通期営業利益1,000億円超、営業利益率16%を見込む

(億円)

	FY2015 (実績)	FY2016 (予想)				通期 対前年 増減
		上期	下期	通期		
		実績	予想	予想		
売上高	6,131	3,409	3,191	6,600	+8%	
SPE	5,762	3,169	2,931	6,100	+6%	
FPD	327	182	258	440	+35%	
営業利益	881	612	438	1,050	+168	
下段：営業利益率	14.4%	18.0%	13.7%	15.9%	+1.5pts	
税前利益	868	575	425	1,000	+131	
親会社株主に帰属する 当期純利益	718	413	307	720	+1	

新生TELの目指す姿

IoTのもたらす未来

2025年 IoTの経済効果

最大\$11兆1,000億

(2015年 \$9,000億)

2020年 ネットに繋がるモノ

500億台

(2014年 142億台)

2019年 半導体市場

\$3,880億

(2014年 \$3,400億)

IPトラフィック

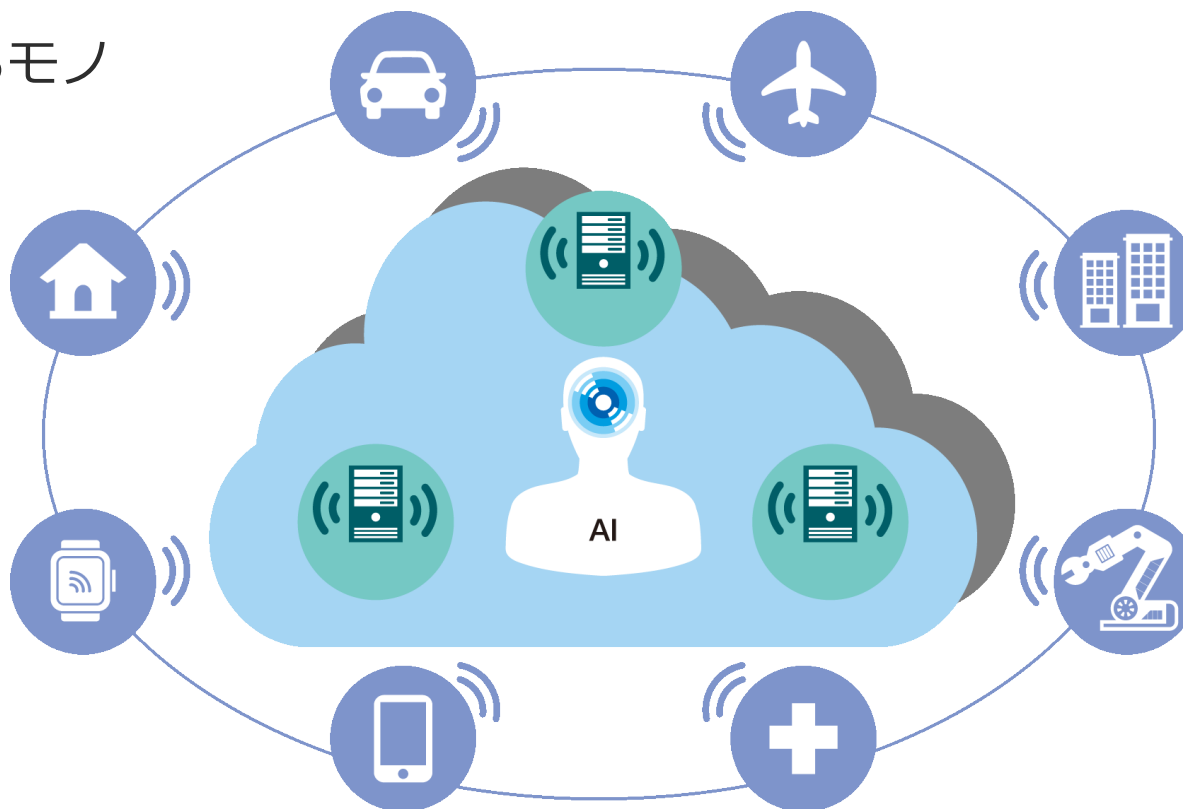
CAGR 23%

(2014年~2019年)

2019年 WFE市場

\$390億

(2014年 \$320億)



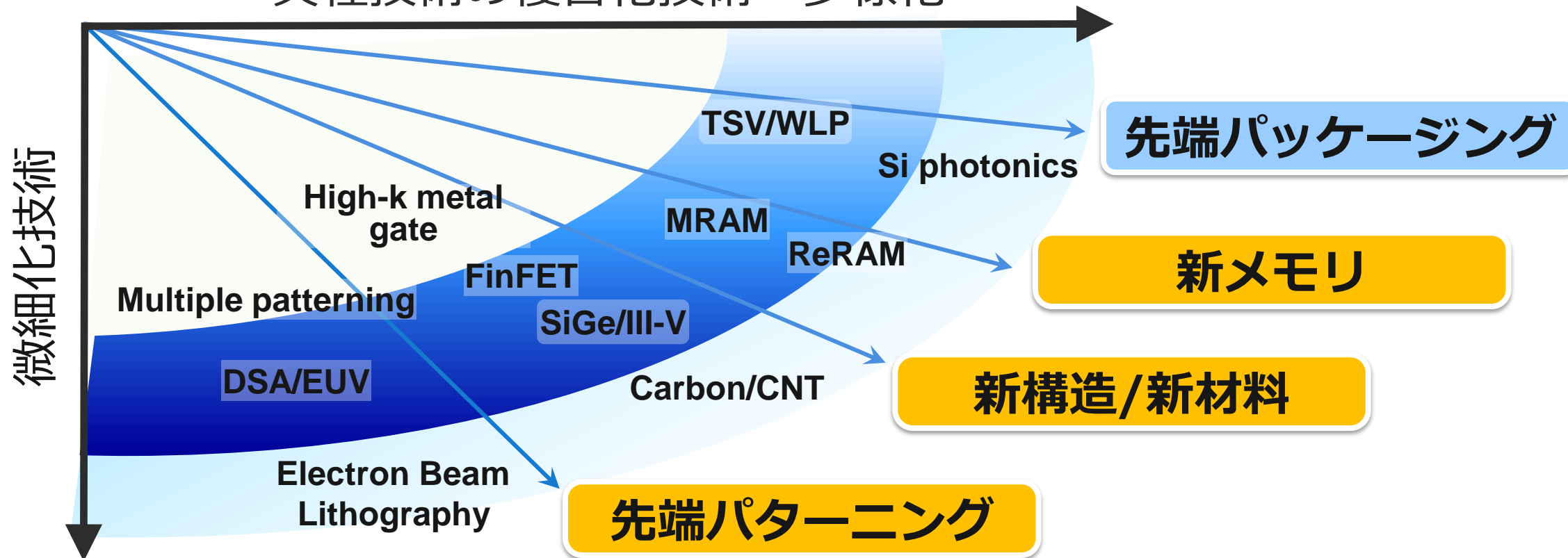
Source: CISCO, McKinsey & Company,

W.W.半導体市場: Gartner, Semiconductor Forecast Database Worldwide 4Q15 Update

W.W.WFE市場: Gartner, Forecast Semiconductor Wafer-Level Manufacturing Equipment Worldwide 4Q15 Update

半導体の技術革新

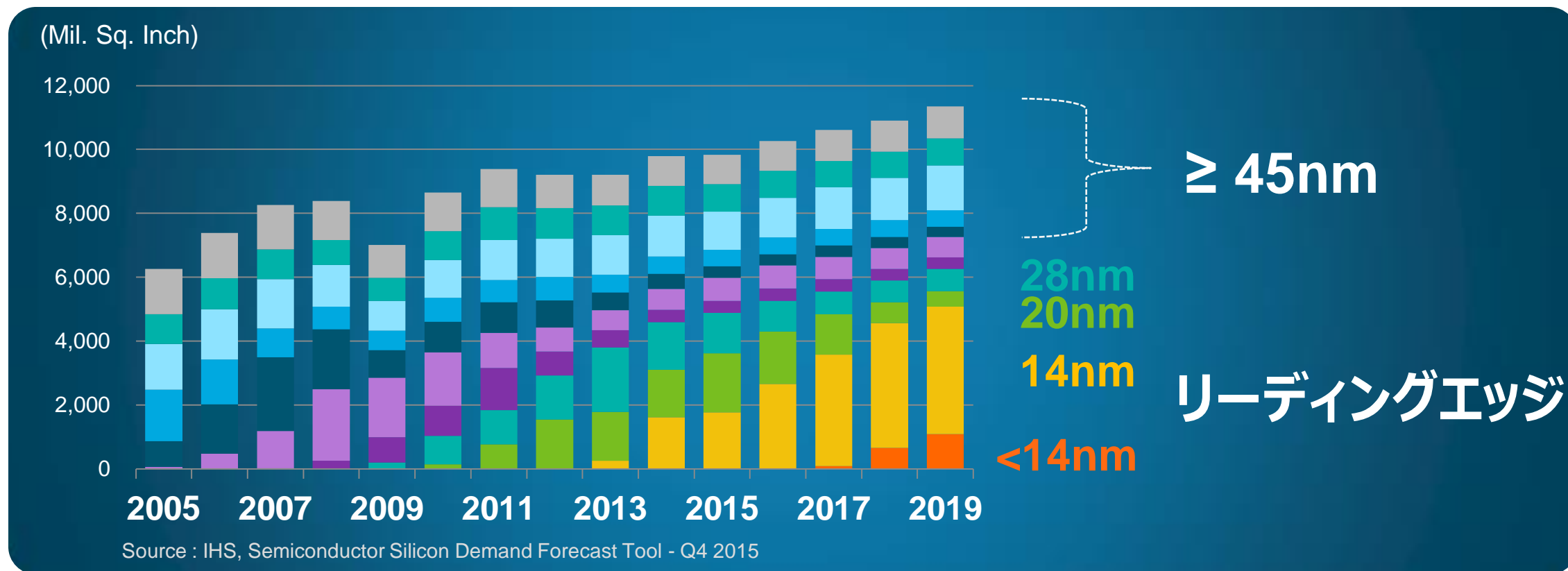
異種技術の複合化技術・多様化



多岐にわたる新技術が半導体の進化を支える

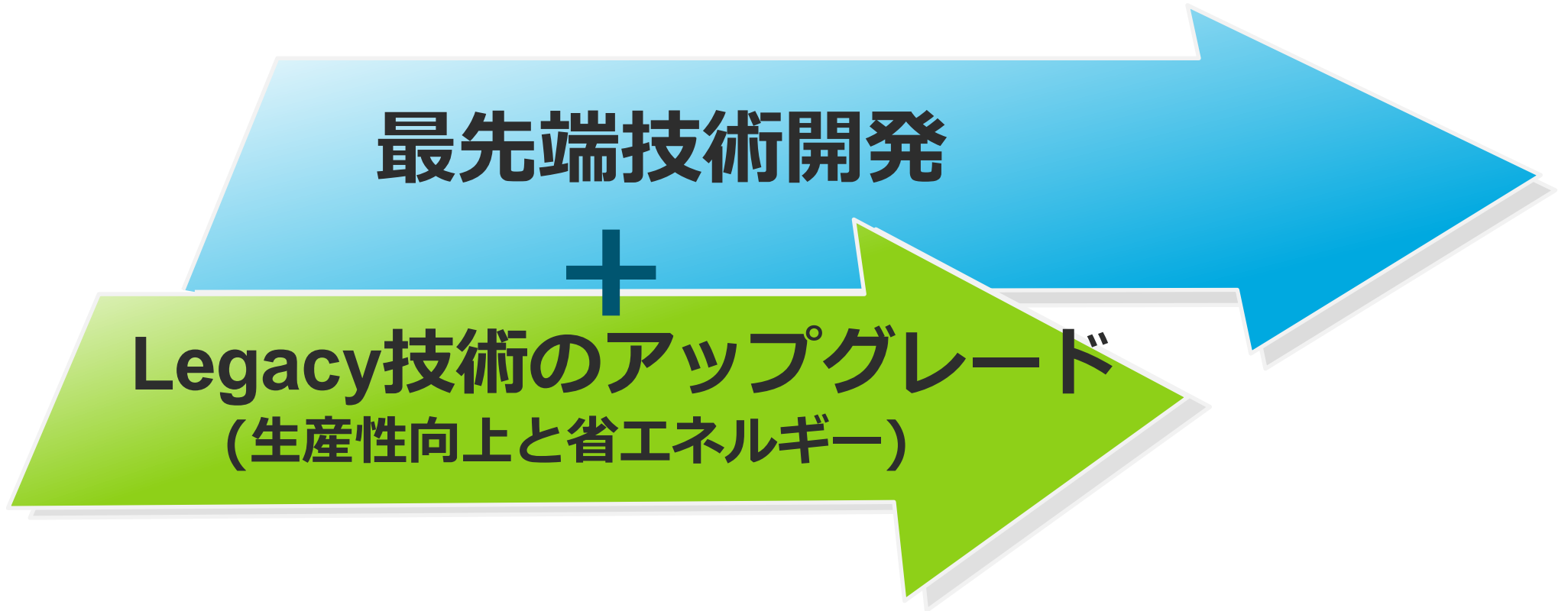
IoTがもたらす半導体プロセスへの影響

ノード別ウェーハ面積消費量



IoTで半導体プロセス技術は多世代同居へ

事業戦略の方向性



プロセス技術の多世代化へ対応

技術の転換点を事業機会に

ステークホルダーの皆さまへ COOメッセージ



求められる技術が
高度になるほど
事業拡大の
チャンス

Expanding our Competitive Strengths to Maximize Growth Opportunities

2015年6月に代表取締役社長・COOに就任いたしました河合です。株主さまをはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまには、日頃からのご支援とご愛顧を賜り、深く感謝を申し上げます。

社会は、従来からのパソコンやモバイル端末に加え、あらゆるモノがインターネットにつながる、いわゆるIoT (Internet of Things) を近未来に迎

えようとしています。米通信機器メーカーのシステムズによると、インターネットで接続される機器は、2014年の145万台に対し2020年には600万台に達すると予測され、これにより世界のIPトラフィック(ネットワーク上で送受信されるデータ)量は2013年から2018年まで年平均21%で成長すると見られています。こうした新時代到来の一翼を担うのが、まさに半導体の技術革

▶ 東京エレクトロンの強みを最大にする新執行体制で、ワールドクラスの製品競争力と収益性を追求していくことで、さらなる企業価値向上を目指します。

新であり、それを支える製造装置の先端技術です。

そして今、半導体業界はかつてないほど激変な技術の転換点を迎えています。半導体は微細化を繰り返すことで、今日まで発展し続けてきました。一方で、微細化が進むにつれて、従来の技術では解決できないさまざまな課題に直面しています。このような状況を打破するために、3D NANDフラッシュメモリやFinFETをはじめとするデバイスの3次元化や、新しい半導体材料の採用、既存の露光技術をベースにエッチングや成膜技術を駆使し微細パターンを形成するマルチパターニング技術などの革新的な技術が生まれています。当社は、こうした新しい技術に対応した製品開発により、2015年3月期は、すべての製品分野においてマーケットシェア向上を達成しました。技術の転換点が事業拡大の最大のチャンスと捉えています。

今後は、新組織体制のもと主力の半導体製造装置およびフラットパネルディスプレイ製造装置事業に注力し、一層の製品競争力の強化を推し進めていきます。まず、リージョン、アカウント制を強力に推進し、従来以上にお客さまのご要望に対して、高次元のソリューションを迅速に提供できる組織体制を構築します。また、求められる技術が高

度になるにつれて、自製品を換断するプロセスのコントロールがますます重要となってきますが、当社は多様な製品を保有する強みを活かし、より付加価値の高い製品の開発に取り組みます。さらには、成長が見込まれる分野にリソースを集中させ、開発の効率を高めることで、製品競争力を加速してまいります。

半導体製造装置およびフラットパネルディスプレイ製造装置市場におけるリーディングカンパニーとして、夢のある未来社会の発展に貢献することで、さらなる企業価値向上を果たしていきたいと考えています。真のグローバルカンパニーになるべく、ワールドクラスの収益性と製品競争力を一貫して追求していく所存ですので、今後とも皆さまの一層のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2015年6月

代表取締役社長・COO
河合 利剛

(アニュアルレポート2015より抜粋)

新生TELビジョン

**革新的な技術力と
多様なテクノロジーを融合する
独創的な提案力で、
半導体とFPD産業に
高い付加価値と利益を生み出す
真のグローバルカンパニー**



TOKYO ELECTRON

新コーポレートロゴ

実現したいこと

1. TELの成長に向け期待いただいている株主への還元
さらなる株主価値向上と新株主還元政策の継続
2. 社員とその家族を豊かにしたい
より役割と貢献度に応じた高い報酬制度
3. 産業界と社会への貢献

利益の追求

企業価値向上

革新的技術力・独創的提案力

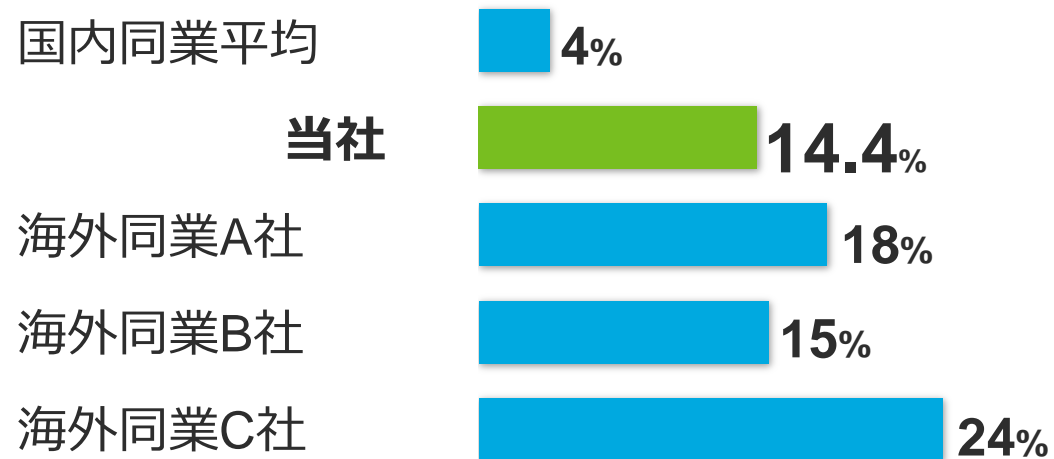
新生TEL 中期方針

1. **Best in Class = “強固な経営基盤”**
2. **Best Fit in New Market = “多様化への対応”**

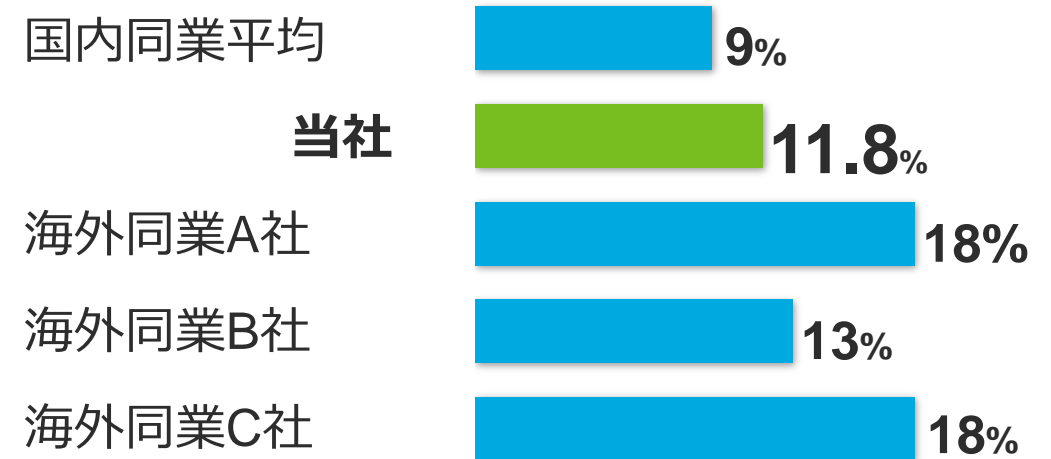


ベンチマーク（直近の会計年度実績）

営業利益率



ROE

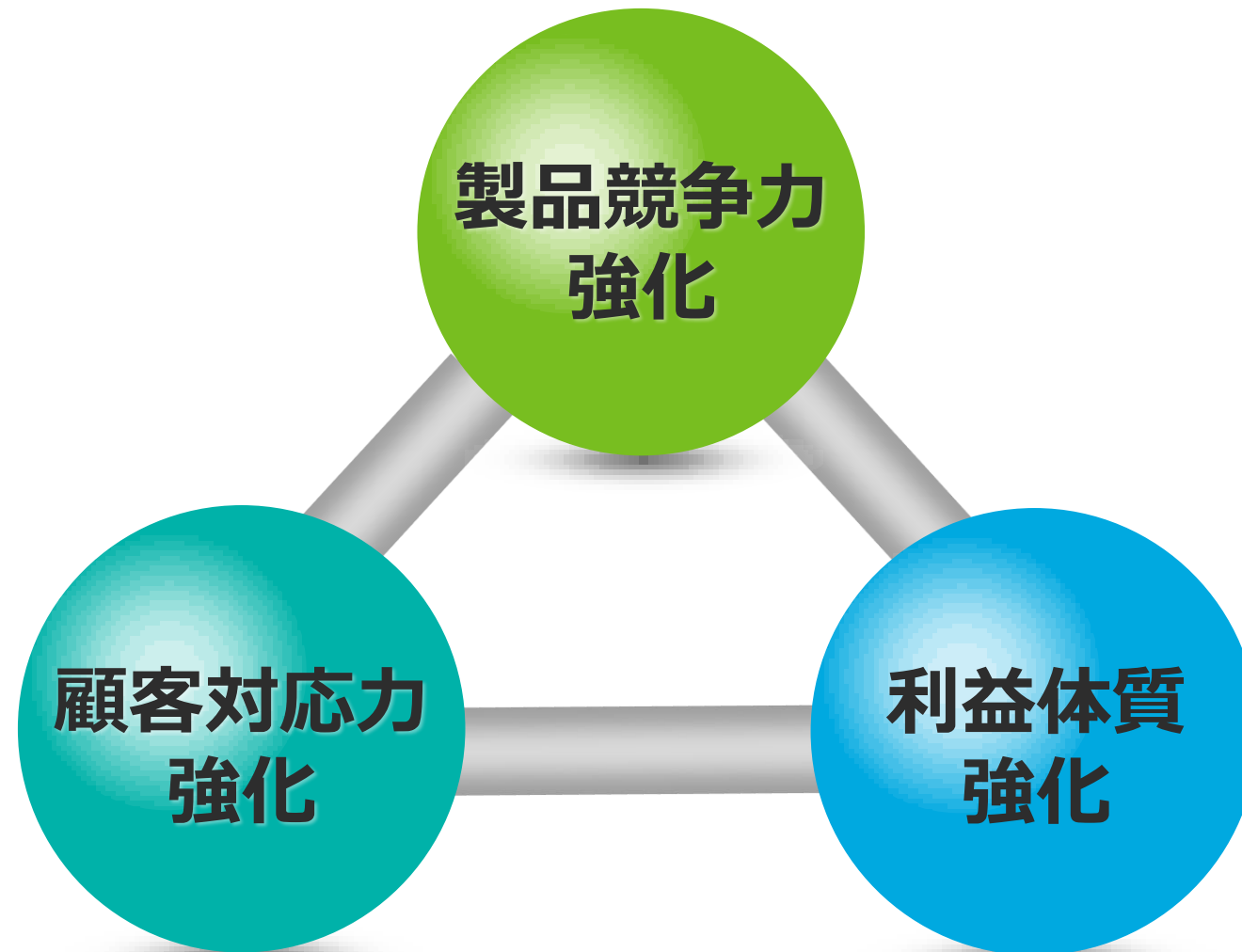


中期経営計画 財務モデル

半導体前工程製造装置 市場規模	\$30B	\$37B
売上高	7,200億円	9,000億円
営業利益率	20%	25%
ROE	15%	20%

目指すのは、グローバル水準の収益力

新生TEL “3つの強化項目”



新執行体制（1月1日付け）



代表取締役社長
CEO
河合 利樹



代表取締役副社長
開発・生産担当
北山 博文

事業本部



本部長(兼)
河合 利樹



副本部長
堤 秀介

BUGM

開発・生産本部



本部長
佐々木 貞夫



副本部長
飽本 正巳



副本部長
鄭 基市

グローバル・フィールド本部



統括本部長
伊東 晃



統括副本部長
鷺野 憲治

コーポレート管理本部



本部長
堀 哲朗



副本部長
長久保 達也

コーポレート・ガバナンス

TELコーポレートガバナンス・ガイドライン制定（2015年12月）

持続的成長に向けた「攻めのガバナンス」実現のための体制

- 監査役会設置会社の機関設計を採用し、監査役会による監督のもと、実効性のあるガバナンスを実現している
 - 「重要な業務執行の意思決定」と「監督機能」を両立させる取締役会



- 経営の公正性、実効性、透明性の確保を目的とする指名委員会と報酬委員会
- 経営戦略の立案、推進機関としてのCorporate Senior Staffの設置

今後の課題と取り組み（主なExplain項目）

- 中期計画との連動性を高めた報酬制度と人事評価の導入
（補充原則 4-2-1、4-3-1）
 - 従来より一定の連動性を確保しているが、中期計画との連動を更に高めた報酬制度を今後検討していく
 - 持続的成長に対するインセンティブを高めることが重要。中期計画への貢献度に応じて、より直接的に連動する人事評価方法を今後検討していく
- 取締役会全体の実効性に関する開示
（補充原則 4-11-3）
 - 取締役会の運営等について、実効性に関する分析・評価を行い、今期より適切に開示していく

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV：フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

TEL™

TOKYO ELECTRON